

LES FINITIONS POUR LES CIRCUITS IMPRIMES:

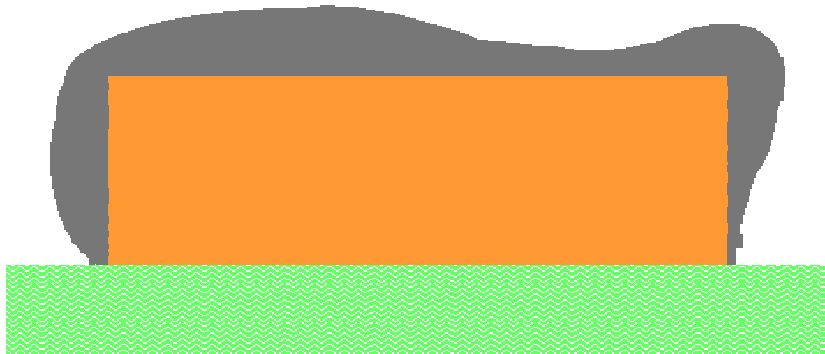
HASL

Etain Chimique

Argent Chimique

Nickel Or Chimique

Nickel Palladium Or



- **Après avoir été fluxée, la carte est trempée dans un bain d'étain-plomb à 250°C**
- **Le couteau d'air chaud nivelle l'alliage en surface.**

Avantages / Inconvénients

**Bonne brasabilité.
Finition économique.
Longue durée de stockage.**

**Planéité (CMS pas fin déconseillés).
Procédé virulent sur le plan thermique.
Attaque du cuivre.**

Le procédé est identique au HASL avec un alliage Sn100C (temp. 270°C)

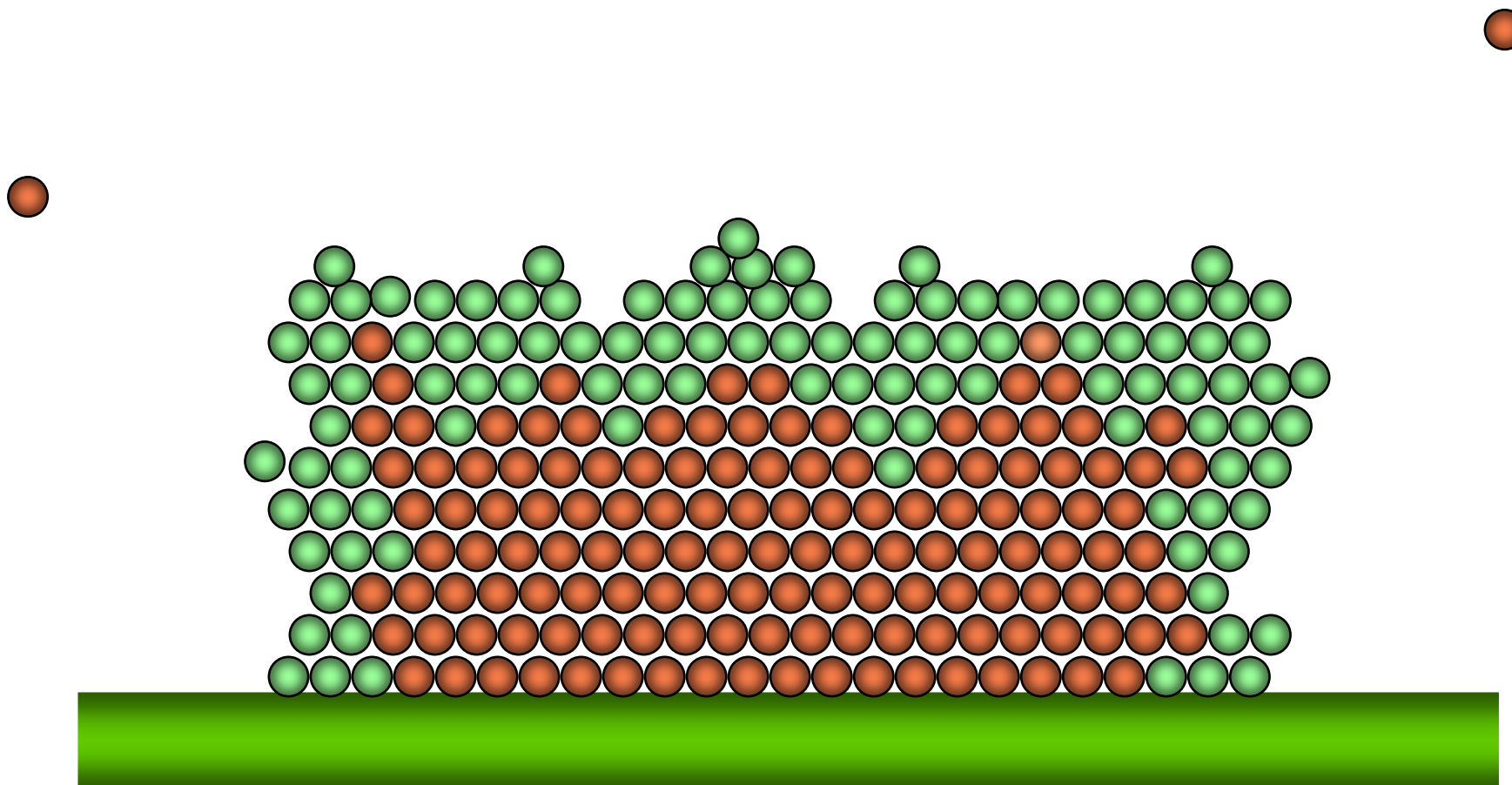
Le dépôt sera plus homogène sur une des faces.



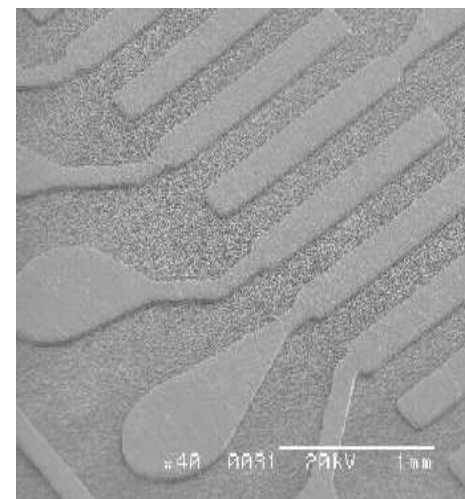
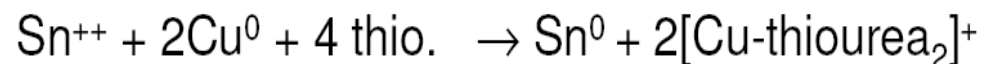
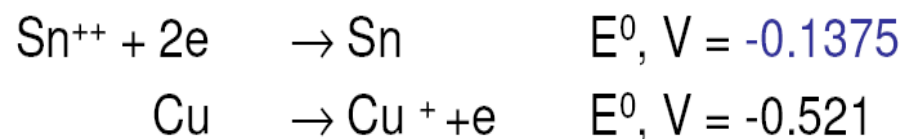
Avantages / Inconvénients

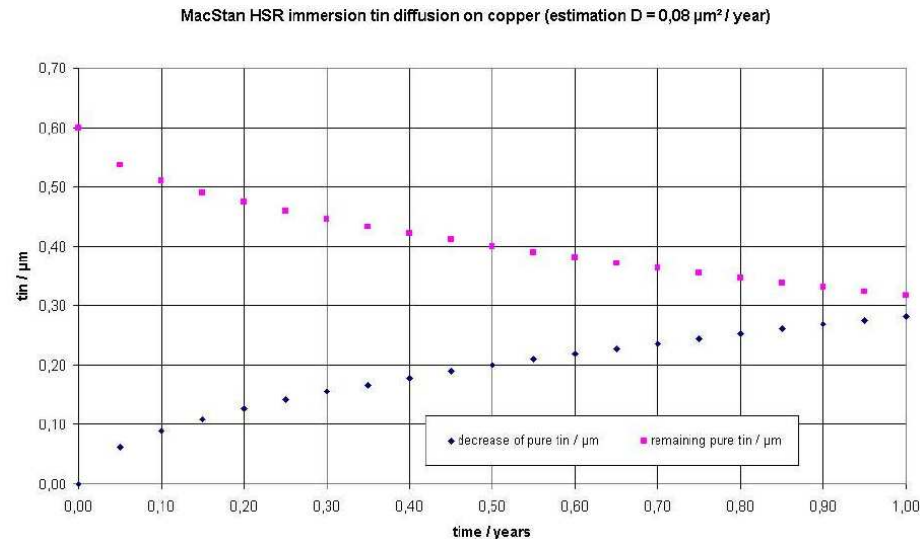
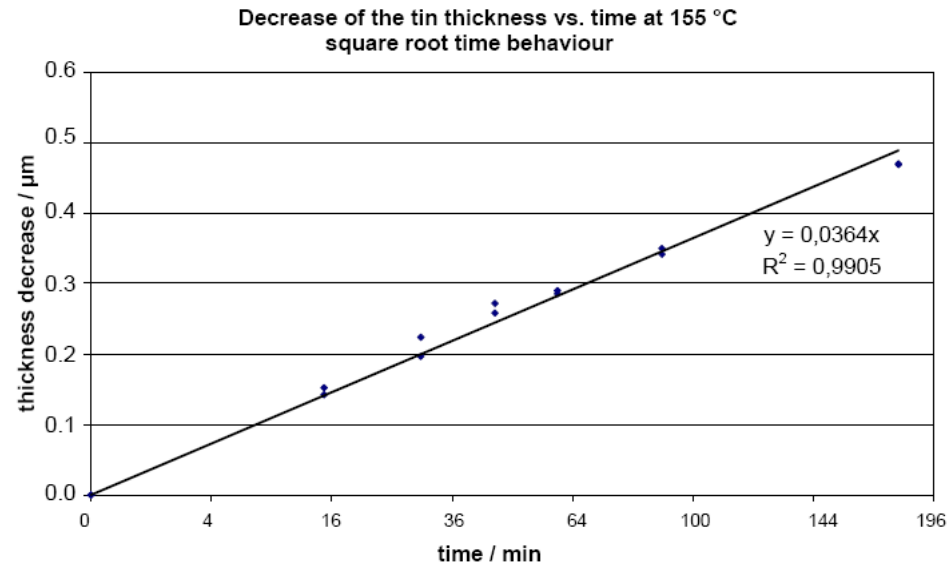
Bonne brasabilité.
Finition économique.
Longue durée de stockage.
Peut être utilisé avec des BGA ≥ 0.8

Planéité moyenne
Procédé virulent sur le plan thermique.
Attaque du cuivre forte.



Dépôt d'Etain Chimique de 0.8 à 1.2µm Formation d'inter métallique CuSn





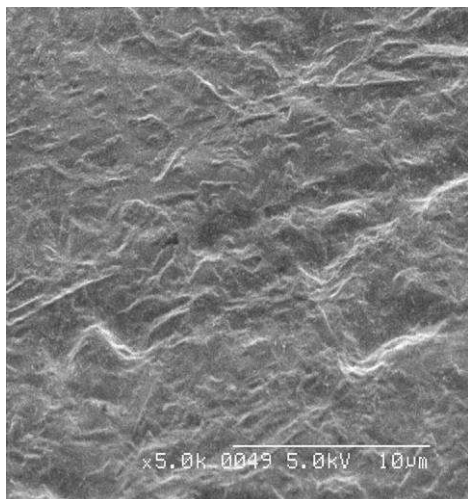
Avantages / Inconvénients

Bonne brasabilité.
Très bonne planéité.
Compatible avec Press-fit.

Vieillesse rapide (0,5 µm mini).
Incompatible avec les produits nécessitants des étuvages conséquents (polyimide, flex-rigide...)

Toutes les phases de soudures doivent être réalisées immédiatement.

Utilisation d'un produit dangereux (Thiourée).



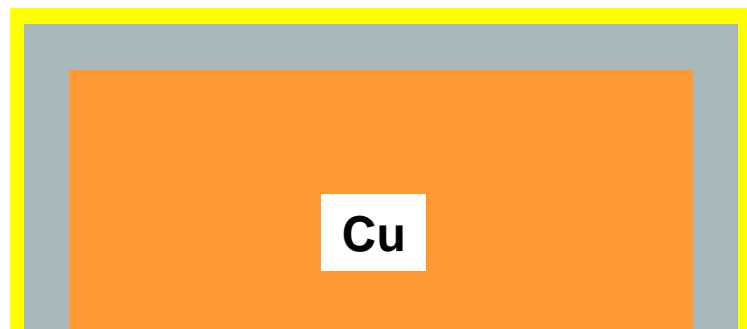
- Dépôt < 0,5 µm d'Argent
- 99% Ag, <1% Carbon



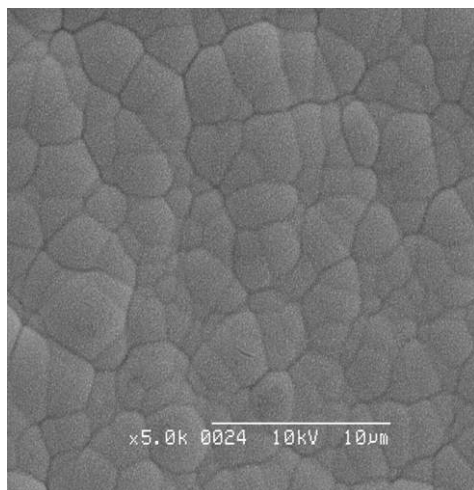
Avantages / Inconvénients

Bonne brasabilité.
Très bonne planéité.
Compatible avec Press-fit.

Vieillessement rapide.
Peu développé en Europe



Substrat



- 4 à 6 μm de Nickel Chimique (7-11% de phosphore)
- 0,05 à 0,12 μm d'Or pur

Avantages / Inconvénients

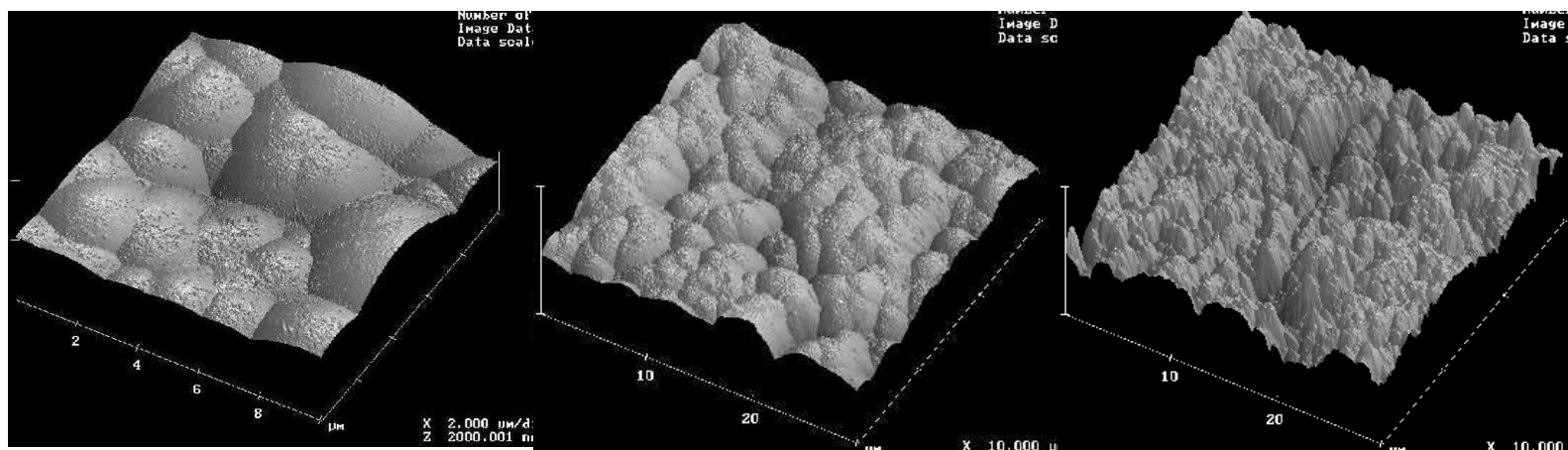
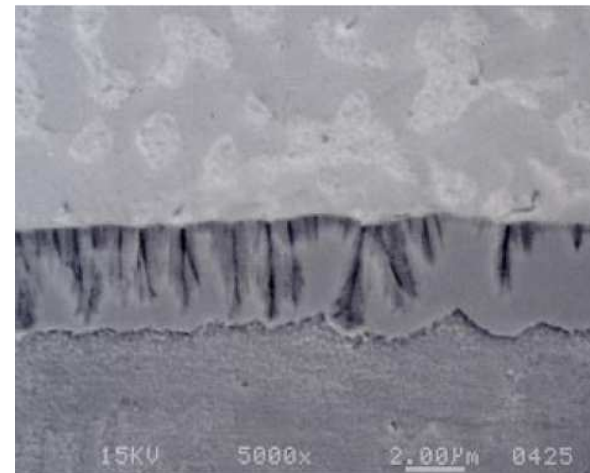
Bonne brasabilité.
Très bonne planéité.
Finition très répandue.
Multiples brasages possibles.
Bonne durée de vie.

La couche de nickel est peu compatible avec les fréquences élevées.
Une oxydation excessive du nickel peut provoquer un défaut de soudabilité.
Coût élevé du fait de l'utilisation de l'or.

La corrosion du Nickel:

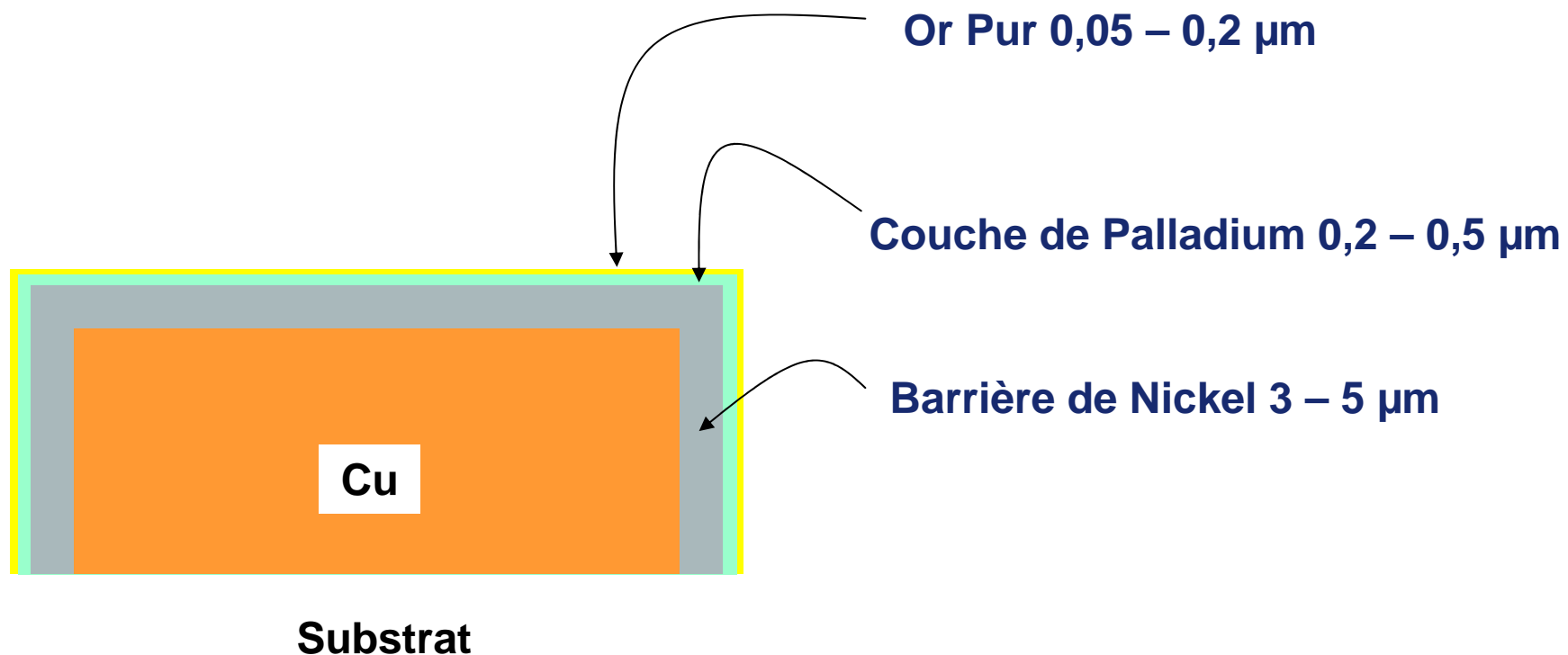
- Dépôt d'or agressif (0,15 – 0,30 μm)
- Pollution organique du Nickel
- Taux de phosphore

Attention, la préparation des échantillons peut provoquer l'attaque du Nickel.



“normal”

“black-line”



La couche de Palladium forme une barrière qui empêche l'oxydation du Nickel.

Développement rapide
Très utilisé dans le secteur médical

Avantages / Inconvénients

Bonne brasabilité.
Très bonne planéité.
Multiples brasages possibles.
Bonne durée de vie.
Compatible avec le ball bounding.

Coût supérieur à l'ENIG
Compte tenu de sa diffusion, un délai de 5 jours sup. est nécessaire.

	HASL	HASL lead free	Etain chimique	Argent chimique	ENIG	ENEPIG
Durée de stockage	> 1 an	1 an	< 6 mois	< 6 mois	1 an	1 an
Planéité	--	-	++	++	++	++
Compatibilité BGA	non	>= pas de 0,8 (1 face)	oui	oui	oui	oui
Press fit	++	++	+	+	-	
Multi soudabilité	++	++	-	-	+	+
Disponibilité (délai court)	+	+	+	=	+	-
Coût	++	++	+	+	=	-

	HASL	HASL lead free	Etain chimique	Argent chimique	ENIG	ENEPIG
Durée de stockage	> 1 an	1 an	< 6 mois	< 6 mois	1 an	1 an
Planéité	--	-	++	++	++	++
Compatibilité BGA	non	>= pas de 0,8 (1 face)	oui	oui	oui	oui
Press fit	++	++	+	+	-	
Multi soudabilité	++	++	-	-	+	+
Disponibilité (délai court)	+	+	+	=	+	-
Coût	++	++	+	+	=	-

Circuit: -HDI

	HASL	HASL lead free	Etain chimique	Argent chimique	ENIG	ENEPIG
Durée de stockage	> 1 an	1 an	< 6 mois	< 6 mois	1 an	1 an
Planéité	--	-	++	++	++	++
Compatibilité BGA	non	>= pas de 0,8 (1 face)	oui	oui	oui	oui
Press fit	++	++	+	+	-	
Multi soudabilité	++	++	-	-	+	+
Disponibilité (délai court)	+	+	+	=	+	-
Coût	++	++	+	+	=	-

Circuit: -HDI

-polyimide

	HASL	HASL lead free	Etain chimique	Argent chimique	ENIG	ENEPIG
Durée de stockage	> 1 an	1 an	< 6 mois	< 6 mois	1 an	1 an
Planéité	--	-	++	++	++	++
Compatibilité BGA	non	>= pas de 0,8 (1 face)	oui	oui	oui	oui
Press fit	++	++	+	+	-	
Multi soudabilité	++	++	-	-	+	+
Disponibilité (délai court)	+	+	+	=	+	-
Coût	++	++	+	+	=	-

Circuit: -HDI

-polyimide
-délai court